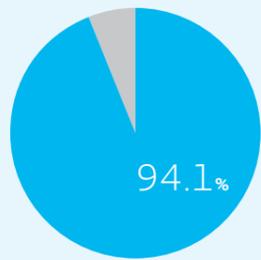


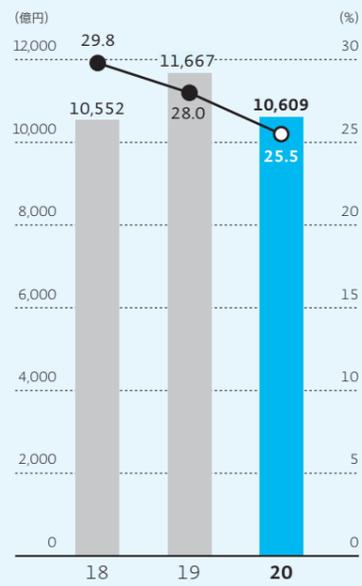
セグメント別営業概況および事業展望



売上高構成比



セグメント売上高と利益率



■ セグメント売上高
●-○ セグメント利益率

セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益に対応しています。

事業環境

2019年は、データセンターや5G対応スマートフォンに使用される高性能プロセッサの需要増加に伴い、ロジックメーカーやファウンドリによる、最先端世代の生産能力増強のための投資が活発におこなわれました。一方、メモリメーカーによる過去数年にわたる生産能力増強は一服し、メモリ向け投資は調整局面となりました。この結果、2013年以降成長を続けてきた半導体前工程製造装置(WFE)^{*1}の市場は前年比8%減少し、約550億米ドルとなりました。

^{*1} 半導体前工程製造装置(WFE; Wafer fab equipment)：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

営業概況

■ セグメント売上高は1兆609億円。WFEの市場規模の縮小に伴い前期比で減収減益となるも、売上・利益ともに業績予想を上回った

- アプリケーション別では、メモリ向けの売上が減少した一方、ロジック/ファウンドリ向けの売上が伸張
- 装置別には、ロジック/ファウンドリ向け投資の増加に伴い、コータ/デベロッパの売上構成比が増加
- フィールドソリューション(パーツ・中古装置販売、改造・保守サービス等)事業の売上高は、前期比5.7%増加。インストールベースの増加と顧客工場の高い稼働率によりパーツ・サービスの売上が引き続き堅調

■ セグメント利益率は、WFE市場の調整局面においても中長期的な成長を見据えた積極的な先行投資を継続した結果、28.0%から25.5%に低下した

事業展望

IoT、AI、5Gの普及に加えて、テレワーク、オンライン授業、遠隔診療などの利用が進み、データ社会への移行が加速しています。データ社会を支える半導体の需要は中長期的に拡大していくと見込まれます。その製造を担う半導体製造装置の中でも、当社は継続的な技術革新と市場拡大がとりわけ見込まれるエッチング・成膜・洗浄装置の3つを中期的な注力分野と位置付け、技術とサービスの差別化による売上および利益成長を目指しています。

DRAM・ロジックにおける微細化や3D NANDの多層化が進むにつれて、新たな材料やより複雑な構造が採用され製造の技術的難度が高まっています。これらの事業機会を成長につなげるため、エッチングでは、HARC工程^{*2}や配線、パターニング工程において加工性能と生産性で競争優位性を高めています。成膜では、バッチ・セミバッチ・枚葉の技術をもつ強みを生かした最適な成膜手法の提案や、新材料に対応した技術の開発を推進しています。洗浄では、微細なパターンの倒壊を抑制する技術や歩留まり低下の要因となる異物や残渣の除去技術を提供しており、3つの注力分野それぞれのSAM^{*3}におけるシェアの拡大を図ります。

また、今後さらなる拡大が見込まれるIoT、車載向けのパワーデバイスやディスクリート半導体市場に対して、過去に製造していた製品の技術資産を利用したりリニューアル装置を投入し、市場シェアの向上を図ります。

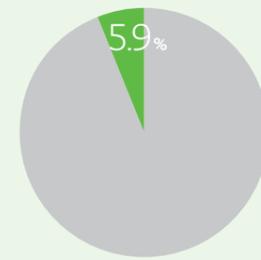
さらに、複数プロセスの相互最適化の重要性が増すとともに、お客さまのアップタイムや歩留まり向上に貢献するサービスの提供が求められています。当社は、多様な製品群の知見を強みに、各技術世代の初期段階からお客さまと共同開発をおこない、相互最適化を実現するインテグレーション技術のいち早い提案を目指します。加えて、装置の遠隔保守やAIを活用した装置診断など、より付加価値の高いサービスの提供を通して、さらなる事業成長を目指します。

^{*2} HARC (High aspect ratio contact) 工程：高度な加工技術を要する深穴や深い溝の形成工程

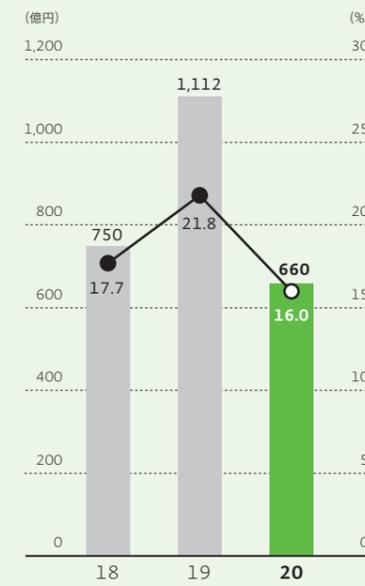
^{*3} SAM : Served available market



売上高構成比



セグメント売上高と利益率



■ セグメント売上高
●-○ セグメント利益率

セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益に対応しています。

事業環境

2019年は、前年に引き続き液晶テレビを目的とした第10.5世代パネル向け投資が高い水準で推移しました。一方、有機ELディスプレイは、前年までの投資の一巡を背景に軟化しました。年後半から有機ELディスプレイを目的とした第6世代パネル向け投資が回復基調に転じましたが、通年では当社が参入するTFTアレイ工程^{*1}向け製造装置市場は前年比25%減少し、約65億米ドルとなりました。

^{*1} TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

営業概況

■ セグメント売上高は前期比40.6%減少の660億円。市場が前年比25%減少したことに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により売上計上が一部遅延したことが主な要因

■ セグメント利益率は前期比5.8ポイント低下の16.0%。売上減少に伴い利益率が低下するも、下方柔軟性の取り組みの成果により収益性を維持できた

事業展望

FPDは、ディスプレイの高精細化や高機能化、デザイン性の追求により、今後も技術革新が期待されています。当社は、高度な技術要求に対して優れたプロセス技術で差別化を図ることで、市場シェアの拡大と営業利益率30%の達成を目指しています。

モバイル用途の中小型パネルにおいては、LTPS^{*2}やIGZO^{*3}などさらなる精細さを実現する技術に加えて、素子が自発光する有機ELディスプレイや折り曲げ可能なフォルダブルデザインが今後採用されていく見込みです。これに伴ってマスク数やドライエッチングの工程は増加し、求められるパターニング精度はより厳しくなると予想されます。拡大する事業機会に対して、当社はドライエッチング装置とコータ/デベロッパの性能をいっそう高めることで事業の成長につなげていきます。

大型ディスプレイにおいては、テレビやハイエンドモニター、車載・パブリックディスプレイなど、さまざまな用途において、液晶から有機ELへの転換が見込まれます。当社は、第10.5世代における競争優位性を引き続き維持するとともに、加工均一性に優れたPICP^{*4}エッチング装置を第8.5・第10.5世代パネル向けに展開しています。

また、これまで第8.5・第4.5世代パネル向けに販売していたインクジェット描画装置についても、量産採用に向けた技術開発を加速するため、第2世代パネル対応の開発ライン向けの新製品をリリースし、複数のお客さまに評価いただいています。中長期的には、ドライエッチング装置とコータ/デベロッパの差別化に加えて、インクジェット描画装置の貢献により、さらなる収益性の向上を図っていきます。

^{*2} LTPS (Low temperature poly-silicon) : 低温ポリシリコン

^{*3} IGZO : インジウム、ガリウム、亜鉛を含む酸化物半導体

^{*4} PICP™ : パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマモジュール